

HANNOVER

>> El Cogiti invita a ingenieros y empresas de ingeniería a la Feria de Hannover 2015

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial ha vuelto a colaborar este año con la delegación en España de la Hannover Messe, que se celebrará del 13 al 17 de abril, con el objetivo de ofrecer la oportunidad de que tanto los colegiados a nivel particular, como las empresas del ámbito de la ingeniería, puedan visitar y participar en este importante encuentro internacional. A los interesados se les enviará un *link* desde donde podrán descargar su entrada gratuita a la feria. El mercado alemán es líder en la industria de automoción, energías renovables, industria aeroespacial, química, electrónica, salud y tecnologías medioambientales, y todos estos sectores estarán representados en Hannover Messe.

De forma paralela, en la Feria de Hannover habrá un espacio dedicado a la gestión del talento dentro de los citados sectores. Esta área se denomina Job and Career, y en ella estarán presentes tanto empresas alemanas como de otros países, para mantener entrevistas con candidatos (previamente concertadas), por un lado, y publicar sus ofertas de empleo, por otro. Este espacio puede resultar muy interesante para todos los colegiados que estén buscando nuevas oportunidades profesionales en el extranjero.

En este sentido, las ventajas que ofrece la delegación en España de la Feria de Hannover se divide en tres apartados, dependiendo del público al que vayan dirigidas:

- Empresas que estén interesadas en participar como expositoras, con posibilidad de instalar un stand conjunto en la Feria para todas ellas, si hubiera un número suficiente de empresas interesadas (consultar condiciones).
- Visitantes: colegiados que quieran visitar la feria, en su conjunto, que obtendrán pases gratuitos (y no tendrán pagar, por lo tanto, los 35 euros que cuesta la entrada por un día).
- Demandantes de empleo: los colegiados que estén interesados en desarrollar una carrera profesional en el extranjero. Obtendrán pases gratuitos para el área de Job and Career, así como para el resto de la feria.

A todos aquéllos que estén interesados en asistir a la Feria de Hannover, se les enviará un enlace desde el que podrán descargarse la entrada e imprimirla para presentarla al entrar en el recinto ferial. Además, en el caso de que se desplace a la feria una delegación formada por ocho o más personas, los beneficios serían los siguientes:

- Bienvenida por parte de la Feria de Hannover.
- Presentación personalizada de los principales temas de Hannover Messe 2015.
- Visita guiada exclusiva y con guía propio.
- Participación en tours de tecnología: www.hannovermesse.de/en/tour

También cabe la posibilidad de participar en el espacio Match & Meet, dirigido a las empresas expositoras y visitantes (clientes potenciales), así como a proveedores no expositores. Este servicio pretende ayudar a aquellos que estén buscando nuevos clientes, socios de negocio, fuentes de información o inversores. El servicio de Match & Meet es gratuito para los visitantes (clientes



potenciales). En el caso de los expositores y proveedores no expositores, tendrán que consultar las condiciones que facilita la organización.

Para poder canalizar y coordinar la asistencia y participación en la feria, tanto de empresas como de colegiados a nivel particular, hay que comunicar la intención de asistir en el correo: hannovermesse@cogiti.es.

Más información: Cogiti. Teléfono: 915 541 806.

BARCELONA

>> Las ferias Graphispag e Hispack aprovechan las sinergias de la impresión del 'packaging'

Con apenas un mes de diferencia, la Fira de Barcelona acogerá dos citas de referencia en España para las industrias gráfica y del embalaje, Graphispag e Hispack. Ambos salones estrechan sus conexiones y aprovechan sinergias para presentar a sus respectivos visitantes el potencial de la impresión de *packaging* ligado a la innovación. En el recinto ferial se verán equipos y tecnologías de impresión, nuevos materiales y soluciones de *smart packaging* y también se aprovecharán los espacios de conocimiento y *networking* para divulgar estas innovaciones y promover la interrelación entre profesionales y expertos.

Con una extensa oferta comercial ligada al mundo de la impresión, los soportes y acabados, la feria Graphispag (24-27 de marzo) propone a los impresores de envases, embalajes y etiquetas nuevas soluciones para su actividad. Asimismo, la innovación y las tendencias cobran máxima importancia y podrán verse en las nuevas áreas del salón, especialmente en la Print Innovation Zone con los últimos desarrollos y avances en impresión funcional, electrónica impresa e impresión 3D, muchos de los cuales se pueden aplicar a la producción de *packaging*. Centros tecnológicos, universidades y empresas explicarán los proyectos en los que están trabajando: etiquetas y envases luminiscentes que se autoabastecen energéticamente, sistemas antifalsificación, creación de prototipos y personalización de *packaging* mediante impresiones tridimensionales, incorporación de sensores impresos, etc.

También el Print Conference Corner de Graphispag acogerá 12 sesiones directamente relacionadas con la impresión de envases, embalajes y etiquetas. Se hablará de impresión digital sobre



cartón ondulado, tintas para *packaging* alimentario, la impresión 3D aplicada al *packaging*, el uso del *offset* en la impresión de embalaje flexible y de etiquetas autoadhesivas, aplicación de diseño estructural y realidad aumentada y automatización de la producción, entre otros temas.

Por su parte, Hispack (21-24 de abril) incluirá en la Trend Pack Area como sectores de tendencia la *mass-customization*, la personalización de *packaging*, el aumento de las tiradas cortas, la creación de prototipos en 3D, etiquetas y *packaging* funcional para producir envases inteligentes o soluciones antifalsificación. En esta área participarán suministradores de tecnología gráfica como HP, Roland, Epson, Rotatek, Durst y Esko, que complementarán el área de *stands* de equipos y producto acabado, con breves conferencias sobre tecnología y experiencias llevadas a cabo.

>> BBB-Construmat presentará las últimas innovaciones en 3D, domótica e IoT

Las tecnologías digitales que están transformando el contexto y el escenario de la construcción a nivel global estarán muy presentes en la nueva edición de la feria Beyond Building Barcelona-Construmat, ya que el evento de Fira de Barcelona dedicará una buena parte de su oferta a demostrar de qué manera las técnicas de fabricación en 3D, los nuevos materiales, los programas informáticos y las plataformas de información y comunicación *online* transformarán la industria de la construcción en un futuro no muy lejano. Internet of Things (IoT) y el emprendimiento, con diversos espacios de encuentro entre inversores y empresas innovadores del sector de la construcción en busca de financiación, también tendrán cabida en esta área temática del salón.

Tradicionalmente, el mundo de la construcción ha sido un sector estrechamente ligado a las nuevas técnicas de diseño, la producción, el transporte y las comunicaciones. Y en la actualidad, cuando expertos de todo el mundo señalan que la tercera revolución industrial se ha hecho ya realidad con la implementación de la fabricación digital en todo tipo de procesos industriales, la feria Beyond Building Barcelona-Construmat ha decidido

apostar firmemente por presentar todo tipo de proyectos, productos y procesos relacionados con las nuevas tecnologías y vinculados al mundo de la construcción como uno de los principales atractivos de la edición de este año.

Así, el eje de Innovación del salón mostrará, en colaboración con el Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya y el FabLab, las últimas novedades tanto en nuevos materiales como en novedosos procesos constructivos, que van desde la construcción de casas con impresoras 3D hasta el uso de robots para construir edificios. El objetivo de la organización es dar a conocer que el futuro pasa por aplicar la tecnología para la construcción de espacios sostenibles e inteligentes.

Entre otros, ponentes como Skylar Tibbits, profesor del departamento de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y el arquitecto británico Alastair Parvin, cofundador del proyecto Wikihouse (un sistema de construcción de código abierto que permite que cualquiera pueda compartir libremente sus archivos para imprimirlos en 3D), explicarán sus proyectos como realidades tangibles.

En este mismo sentido, la tecnología BIM (Modelo de Información para la Construcción) –proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida, utilizando *software* de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real– estará también presente en BBB-Construmat. Y es que, a partir del año que viene, todos los países de la Unión Europea estarán obligados a fomentar el uso de esta tecnología para proyectos de construcción financiados con fondos públicos. En estos momentos, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlandia y Noruega ya lo exigen.



MADRID

>> El II Foro de Desarrollo Minero Metalúrgico Sostenible convoca su galería de innovación

El II Foro de Desarrollo Minero Metalúrgico Sostenible, que organizado por IFEMA y el grupo TPI, en colaboración con Confedem, se celebrará entre los próximos 12 y 13 de mayo, presentará la II Galería de Innovación, una iniciativa que tiene por objeto mostrar una selección de desarrollos en minería avanzados tec-